

【11】證書號數：I663692

【45】公告日：中華民國 108 (2019) 年 06 月 21 日

【51】Int. Cl. : *H01L23/14 (2006.01)* *H01L23/15 (2006.01)*
G01L9/00 (2006.01)

發明

全 2 頁

【54】名稱：壓力感測器封裝結構

【21】申請案號：107106587 【22】申請日：中華民國 107 (2018) 年 02 月 27 日

【72】發明人：田炯岳 (TW)；張政嶢 (TW)；蘇美燕 (TW)；杜明德 (TW)

【71】申請人：菱生精密工業股份有限公司

臺中市潭子區台中加工出口區南二路 5 之 1 號

【74】代理人：吳宏亮；劉緒倫

【56】參考文獻：

TW 200903680

TW 200939361

TW 201126688A1

TW 201539677A

審查人員：邱迺軒

【57】申請專利範圍

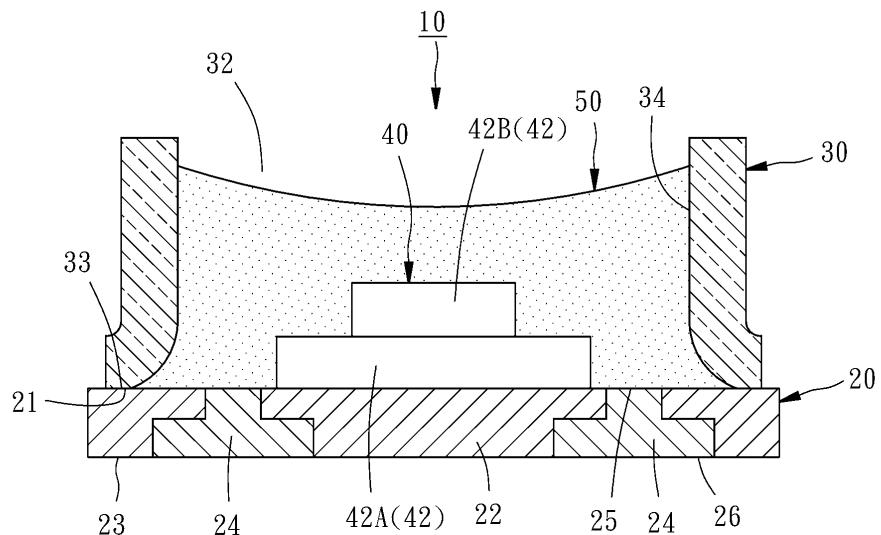
1. 一種壓力感測器封裝結構，包含：一封裝導線架，具有一模壓膠層以及多個導線架單元，該模壓膠層具有一頂面以及一側周面，該等導線架單元設置於該模壓膠層中；一側壁，設置於該模壓膠層的頂面並圍繞形成一容置區；一壓力感測模組，設置於該模壓膠層之頂面並且位於該容置區中；以及一封裝矽膠，設置於該容置區並包覆該壓力感測模組；其中，該等導線架單元分別位於該側壁與該壓力感測模組之間，且未顯露於該模壓膠層之側周面之外。
2. 如申請專利範圍第 1 項所述壓力感測器封裝結構，該模壓膠層更具有一底面，該等導線架單元的頂端及底端係分別自該模壓膠層的頂面及底面露出。
3. 如申請專利範圍第 1 項所述壓力感測器封裝結構，該側壁係為模壓樹脂或金屬材質。
4. 如申請專利範圍第 1 項所述壓力感測器封裝結構，該壓力感測模組包含多個晶片單元，該等晶片單元係以相互堆疊的方式設置於該模壓膠層的頂面。
5. 如申請專利範圍第 1 項所述壓力感測器封裝結構，該壓力感測模組係藉由金屬線電性連接於該等導線架單元，或是藉由覆晶製程(Flip-chip)電性連接於該等導線架單元。
6. 如申請專利範圍第 1 項所述壓力感測器封裝結構，該模壓膠層係為環氧樹脂。
7. 如申請專利範圍第 1 項所述壓力感測器封裝結構，該等導線架單元係為金屬材質。

圖式簡單說明

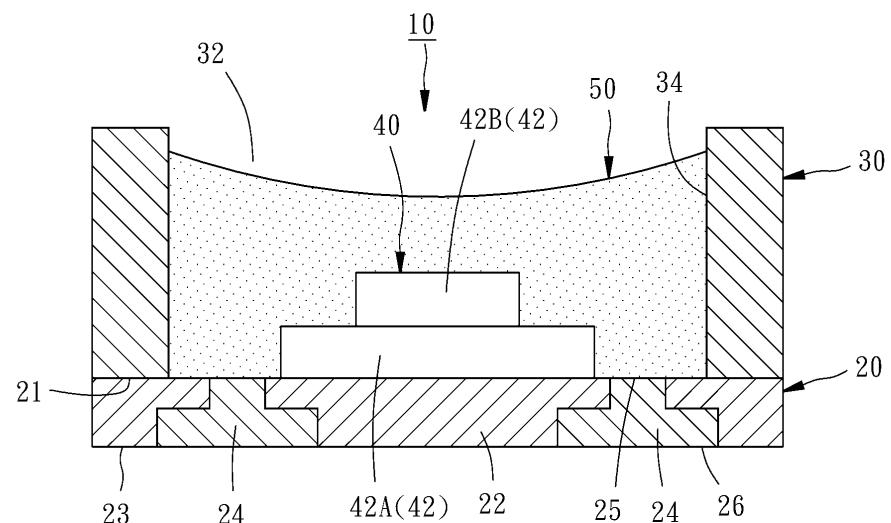
第 1 圖為本發明第一較佳實施例的剖視圖。

第 2 圖為本發明第二較佳實施例的剖視圖。

(2)



第1圖



第2圖